SERVICIOS TECNOLÓGICOS LABORATORIO DE ELECTRÓNICA

| SENA |
|----------|
| 7 |
| // // |

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL LABORATORIO

CÓDIGO: GLE-F-002 VERSIÓN: 03 FECHA: 06-05-2025 Página 1 de 2

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | | |
|--|------------|----------|------------|--|--|--|--|
| Nombre: | brayan | | | | | | |
| Fecha: | 16-09-2025 | Celular: | 3232274352 | | | | |
| Servicio | | | | | | | |
| ☑ Diseño de tarjetas de circuito impreso | | | | | | | |
| ☑ Fabricación de tarjetas de circuito impreso | | | | | | | |
| ☐ Impresión de piezas 3D | | | | | | | |
| □ Diseño de piezas 3D | | | | | | | |
| ☑ Transferencia de conocimientos y/o tecnologías | | | | | | | |
| ☑ Montaje de componentes electrónicos | | | | | | | |
| ☐ Fabricación o integración de soluciones tecnológicas | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| (| ASPECTOS A EVALUAR | | NO | N/A |
|-----|--|--|-------------|-------------|
| 1 | Diseño de tarjetas de circuito impreso | | | |
| 1.1 | Requiere normas especiales de diseño (MIL, UL, IPC) | | \boxtimes | |
| 1.2 | Requiere análisis térmico | | | |
| 1.3 | Requiere análisis mecánico | | | \boxtimes |
| 1.4 | Requiere análisis de radio frecuencia | | | \boxtimes |
| 2 | Fabricación de tarjetas de circuito impreso | | NO | N/A |
| 2.1 | El equipo se encuentra disponible para el desarrollo del proceso | | | |
| 2.2 | Es menor o igual al máximo tamaño permitido (280mm x 210mm) | | \boxtimes | |
| 2.3 | Se puede fabricar en material FR4 de 1 o 2 caras calibre 1.5 mm | | \boxtimes | |
| 2.4 | Las perforaciones son menores o iguales a (0.4mm) | | | \boxtimes |
| 2.5 | El ancho de las pistas es menor o igual a 0.2 mm | | \boxtimes | |
| 2.6 | El espacio entre pistas, vías y pads es mayor o igual a 0.1mm | | \boxtimes | |
| 2.7 | Acabado Anti-solder color verde | | | |
| 2.8 | Acabado silk-screen color blanco | | | |
| 2.9 | Hueco metalizado | | | |
| 3 | Fabricación o integración de soluciones tecnológicas | | NO | N/A |
| 3.1 | Requiere cumplimiento de normas especiales de productos electrónicos (IPC clase 2 o 3) | | | |
| 3.2 | Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias | | | |
| 4 | Transferencia de conocimientos y/o tecnologías | | NO | N/A |
| 4.1 | Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias | | | |
| 4.2 | Se cuenta con los materiales necesarios para realizar la transferencia | | | |

SERVICIOS TECNOLÓGICOS LABORATORIO DE ELECTRÓNICA

| SENA |
|----------|
| 7 |
| // // |

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL LABORATORIO

| CÓDIGO: GLE-F-002 |
|-------------------|
| VERSIÓN: 03 |
| FECHA: 06-05-2025 |
| Página 2 de 2 |

| 5 | Diseño de piezas en 3D | SI | NO | N/A | | | |
|---|--|----|----|-----|--|--|--|
| 5.1 | El software de diseño se encuentra autorizado para uso institucional | | | | | | |
| 5.2 | El diseño debe cumplir con medidas exactas para ensamblaje | | | | | | |
| 6 | Impresión de piezas en 3D. | SI | NO | N/A | | | |
| 6.1 | La impresora se encuentra disponible para el desarrollo del proceso | | | | | | |
| 6.2 | 6.2 El software del equipo está actualizado para la fabricación | | | | | | |
| 6.3 | 3 Los materiales de impresión solicitados están disponibles | | | | | | |
| 6.4 | 6.4 El diseño a imprimir cumple con las condiciones de tamaño del equipo | | | | | | |
| 6.5 | Se cuenta con las especificaciones de boquilla necesaria | | | | | | |
| 7. | Montaje de componentes electrónicos | | NO | N/A | | | |
| 7.1 | Los equipos de soldadura adecuados se encuentran disponibles | | | | | | |
| 7.2 | Hay disponibilidad de insumos adecuados para el trabajo solicitado | | | | | | |
| 7.3 | Hay disponibilidad de equipos para las pruebas de continuidad eléctrica | | | | | | |
| Aprobado: ⊠SI □NO | | | | | | | |
| Observaciones: bubububbgftdtjf tfytfyi | | | | | | | |
| | Responsable de la gestión técnica y administrativa | _ | | | | | |